



## Endoberflächen / Lötflächen

Verfahren	HAL Verzinnung bleifrei	chem. Zinn	chem.Silber	OSP	chem. NiAu		galv. Ni/Au
					Sudgold	Reduktivgold / Bondgold	Hartgold
Schichtstärke $\mu$	1 - 50	0,8 - 1,3	0,2 - 0,4	0,02 - 0,06	0,05 - 0,12Au 4-8 Ni	0,3 - 0,6 Au 4-8 Ni	0,8 - 5 Au 4-8 Ni
Planarität	befriedigend	sehr gut	sehr gut	sehr gut	sehr gut	sehr gut	sehr gut
Lagerfähigkeit bei stabilen Konditionen	>12 Mon.	<12 Mon.	<12 Mon.	< 3 Mon.	>12Mon.	>12 Mon.	>12 Mon.
Mehrfachlötbarkeit	sehr gut	befriedigend	gut	schlecht	sehr gut	sehr gut	-
Reaktivierbarkeit	ja	ja	nein	ja	nein	nein	nein
Alu-Draht-Bonden	nein	nein	bedingt	nein	ja	ja	-
Gold-Draht-Bonden	nein	nein	nein	nein	nein	ja	-
Drucktasten-Kontakt	nein	nein	nein	nein	ja	ja	ja
Einpresstechnik	ja	ja	ja	nein	bedingt	bedingt	nein